



现行对外投资规则下的禁止性与须通知交易
以及《COINS 法案》下的禁止性与须通知技术（按行业划分）

行业	现行对外投资规则下的禁止性交易	现行对外投资规则下的须通知交易	《COINS 法案》下的“禁止性技术”	《COINS 法案》下的“须通知技术”
半导体	<ol style="list-style-type: none">1. 开发或生产用于集成电路设计或先进封装的电子设计自动化（EDA）软件；2. 开发或生产以下任何产品：<ol style="list-style-type: none">(a) 为批量制造集成电路而设计的前端半导体制造设备；(b) 进行批量先进封装的设备；或(c) 专门用于或与极紫外光刻制造设备（EUV）一起使用的商品、材料、软件或技术；3. 设计任何符合或超过出口管制分类编码（ECCN）3A090.a 项下性能参数的集成电路或在 4.5 开尔文或更低温度下工作的集成电路；4. 制造以下产品：<ol style="list-style-type: none">(a) 使用非平面晶体管结构或生产技术节点为 16/14 纳米或更低的逻辑集成电路；(b) 128 层或更多层的与非门 (NAND) 存储器集成电路；	设计、制造或封装任何集成电路。	先进半导体技术与微电子	半导体技术与微电子

行业	现行对外投资规则下的禁止性交易	现行对外投资规则下的须通知交易	《COINS 法案》下的“禁止性技术”	《COINS 法案》下的“须通知技术”
	<p>(c) 采用 18 纳米半间距或更小技术节点的动态随机存取(DRAM) 存储器集成电路；</p> <p>(d) 用镓基化合物半导体制造的集成电路；</p> <p>(e) 使用石墨烯晶体管或碳纳米管的集成电路；或</p> <p>(f) 为在 4.5 开尔文或更低温度下工作而设计的集成电路；</p> <p>5. 使用先进封装技术进行的任何集成电路的封装。</p>			
超级计算机	开发、安装、销售或生产任何由先进集成电路支持的超级计算机，该等超级计算机可以在不超过 41,600 立方英尺或更小的尺寸内提供 100 或以上的双精度（64 位）或 200 或以上的单精度（32 位）每秒千万亿次浮点运算的理论计算能力；	无	高性能计算与超级计算（目前尚不明确“高性能计算”的额外监管范围）	高性能计算与超级计算（目前尚不明确“高性能计算”的额外监管范围）
量子技术	<p>开发量子计算机或生产量子计算机所需的关键部件，如稀释制冷机或两级脉冲管式低温冷却器；</p> <p>开发或生产为了用于或相关受限外国主体打算将其用于军事、政府情报或大规模监视用途的量子传感平台；</p> <p>开发或生产用于（1）联网以扩大能力；（2）进行安全通信；或（3）军事、政府情</p>	无	量子信息技术	量子信息技术

行业	现行对外投资规则下的禁止性交易	现行对外投资规则下的须通知交易	《COINS 法案》下的“禁止性技术”	《COINS 法案》下的“须通知技术”
	报或大规模监视的最终用途的量子网络或量子通信系统。			
人工智能 (AI)	<p>开发任何专门用于以下用途的人工智能系统，或相关受限外国主体打算将其用于以下用途的人工智能系统：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 军事最终用途；或 2. 政府情报或大规模监视的最终用途； <p>开发任何使用以下计算能力进行训练的人工智能系统：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 10^{25} 次运算操作（如整数或浮点运算）；或 2. 主要使用生物序列数据的 10^{24} 次计算操作（如整数或浮点运算）。 	<p>开发其他禁止类交易定义范围以外的人工智能系统，且该人工智能系统满足以下任一条件：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 设计用于任何军事最终用途，或政府情报或大规模监视最终用途； 2. 旨在用于以下用途： <ol style="list-style-type: none"> (a) 网络安全应用， (b) 数字取证工具， (c) 渗透测试工具，或 (d) 机器人系统的控制；或 (e) 用大于 10^{23} 运算操作（例如整数或浮点运算）的计算能力进行训练。 	人工智能系统	人工智能系统
高超音速系统	未纳入监管范围	未纳入监管范围	高超音速系统	高超音速系统